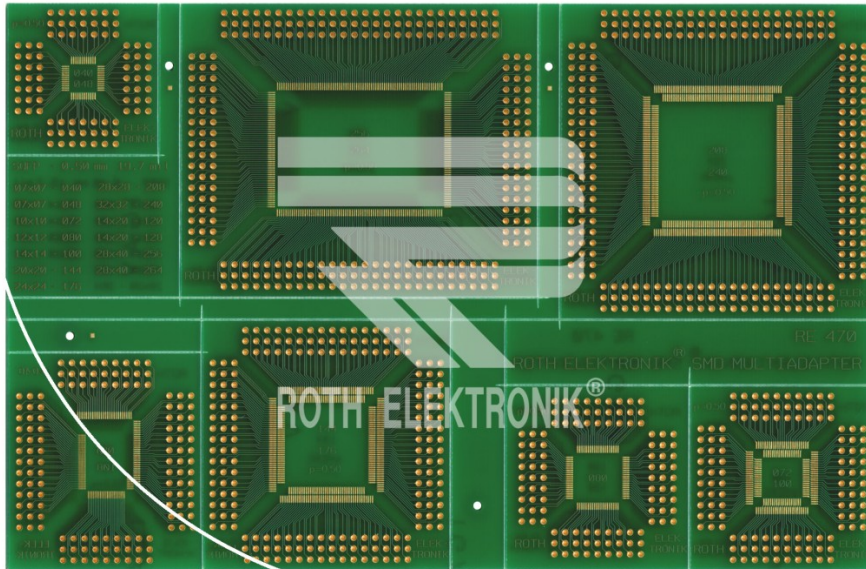


**SMD-QFP Multiadapter**



**RE470**



- Epoxyd FR4 1,50 mm, zweiseitig 35 µm CU (durchkontaktiert)
- zwei Komponentenseiten mit einer absolut planen chem. Nickel/Sudgold Endoberfläche und Lötstoppmasken
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Pad Abstände 0,40 mm (15,7 mil) und 0,50mm (19,7mil)
- Adaptionplatine für 23 verschiedene SMD-QFP's
- Vorgeritzte Sollbruchstellen zum Trennen einzelner Module von der Platine
- Gerberdaten zur Herstellung der Lötstoppmaske und des Lötpastenaufdrucks werden auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt
- Größe 132 x 203 mm

Modul-Nr	Pitch	Pin	mil	Gehäuse (mm)
RE470-01	S 0,500 mm	QFP 40, 48	19,7	7 x 7
	S 0,400 mm	QFP 80	15,7	10 x 10
RE470-02	S 0,500 mm	QFP 80	19,7	12 x 12
	S 0,400 mm	QFP 100, 108	15,7	12 x 12
RE470-03	R 0,500 mm	QFP 120, 128	19,7	14 x 20
	R 0,400 mm	QFP 100, 108	15,7	10 x 14
RE470-04	S 0,500 mm	QFP 72, 100	19,7	10 x 10
	S 0,400 mm	QFP 12	15,7	14 x 14
RE470-05	S 0,500 mm	QFP 144, 176	19,7	20 x 20, 24 x 24
	S 0,400 mm	QFP 184	15,7	20 x 20
RE470-06	R 0,500 mm	QFP 256, 264	19,7	28 x 40
	R 0,400 mm	QFP 224, 232	15,7	20 x 28
RE470-07	S 0,500 mm	QFP 208, 240	19,7	28 x 28, 32 x 32
	S 0,400 mm	QFP 264	15,7	28 x 28